

AVVISO

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di una “linea per bonding permanente e temporaneo e debonding di wafers in silicio” da installare nel laboratorio Clean Room Detector della Fondazione Bruno Kessler per lo sviluppo della facility "3D Integration" nell’ambito del progetto “IPCEI Microelettronica” - CUP: B61B19000870005 – CIG 8801128894

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che il giorno **25/10/2021 alle ore 14:00** il Seggio di gara si riunirà per procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Si informano pertanto i concorrenti, qualora interessati, che per partecipare alla seduta in oggetto è possibile collegarsi al seguente link: meet.google.com/bcy-grre-fyp. Per poter partecipare alla seduta è necessario trasmettere, entro il termine di cui sopra, apposito documento di identità o apposita delega (se soggetto diverso dal legale rappresentante) al seguente indirizzo PEC gare@pec.fbk.eu.

Cordiali saluti

- Paola Angeli –

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Responsabile Servizio Appalti e Contratti

(doc. firmato digitalmente)